Об аномальном тепловом расширении высокотемпературных сверхпроводников при низких температурах

© А.И. Головашкин, А.П. Русаков*

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 119991 Москва, Россия * Московский государственный институт стали и сплавов, 117936 Москва, Россия E-mail: golov@sci.lebedev.ru

(Поступила в Редакцию в окончательном виде 25 декабря 2006 г.)

Рассмотривается природа аномального (отрицательного) теплового расширения высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) при низких температурах и аномально сильного влияния магнитного поля на коэффициент теплового расширения в этой области температур. Предложена физическая модель, основанная на стабилизирующей роли волны зарядовой плотности (ВЗП), возникающей в кислородной подрешетке, в дополнение к антиферромагнитному и спин-пайерлсовскому упорядочению в подрешетке ионов меди в ВТСПсистемах. Рассмотрено влияние температуры, магнитного поля и легирования на характер взаимодействия такой ВЗП с ионной решеткой ВТСП-системы. Выводы модели согласуются с результатами эксперимента.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04-02-16455) и Минобрнауки.

PACS: 74.72.-h, 74.25.Bt, 74.25.Jb

1. Введение

Со времени открытия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) выполнено огромное число исследований их свойств. Тем не менее остается еще целый ряд нерешенных фундаментальных проблем, относящихся к механизму сверхпроводимости и природе основного состояния в этом классе соединений. В диэлектрической фазе ВТСП-систем, как известно [1], наблюдается энергетическая щель в электронном спектре E_{ct}, которая возникает в них из-за переноса заряда Cu3d-O2p, причем E_{ct} меньше U — величины моттхаббардовского межэлектронного Cu3d-Cu3d-отталкивания. Это состояние диэлектрика с переносом заряда сохраняется и в некотором интервале составов при легировании. Возникновение энергетической щели E_{cr} может проявляться в структурных особенностях диэлектрической фазы ВТСП-систем и наличии целого ряда аномалий их свойств. Действительно, аномалии в этих системах наблюдаются для температурных зависимостей низкоэнергетической фононной моды в направлении [100] [2], коэффициента теплового расширения $\alpha(T)$ при низких температурах [3], скоростей ультразвука [4], упругих модулей [5], структурных параметров [6] и других характеристик. Все это указывает на то, что ВТСП являются неустойчивыми кристаллохимическими системами. На неустойчивость таких систем указывает также сильное влияние магнитных полей на эти аномалии [4,5,7].

Для выяснения природы аномалий свойств ВТСПсистем, в частности аномалий их теплового расширения при низких температурах, наблюдавшихся как в наших работах, так и в работах других исследователей, необходимо рассмотреть природу основного состояния этих систем с учетом последних экспериментальных и теоретических результатов. В настоящей работе рассматривается электронная структура ВТСП-систем, приводящая к возникновению в них аномального теплового расширения при низких температурах и к аномально сильному влиянию магнитного поля на тепловое расширение, а также обсуждается влияние легирования на эти свойства. Выводы из представленной в данной работе модели согласуются с результатами проведенных недавно экспериментальных исследований теплового расширения монокристаллов $Bi_2Sr_{2-x}La_xCuO_6$ в широком интервале составов [8], а также с результатами предыдущих исследований других ВТСП-систем [7,9–19].

2. Модель

1) Выполненные в последнее время нейтронографические исследования на высококачественных монокристаллах системы La2-rSrrCuO4 подтвердили, что в образцах без легирования (т.е. при x = 0) магнитный момент ионов меди равен половине магнетона Бора: $\mu_{\rm Cu} = 0.5 \mu_{
m B}$ [20]. Эта величина меньше, чем теоретическое значение $\mu_{\rm Cu,th} = g \langle S_i^Z \rangle \approx 0.67 \mu_{\rm B}$ (при типичном для Cu^{+2} значении фактора Ланде $g \approx 2.2$). Здесь $\langle S_i^Z \rangle$ — ожидаемое среднее значение спина иона меди, находящегося на *j*-м месте, в двумерной модели антиферромагнетика Гейзенберга при спине S = 1/2. Из-за учета нулевых колебаний величина $\langle S_i^Z \rangle$ уменьшается от 1/2 до 0.3034 [21]. Результаты теории и эксперимента согласуются при условии, что заряд (валентность) ионов меди в диэлектрике не Cu^{+2} , а $Cu^{+1.75}$, т. е. из-за гибридизации с 2р-состояниями ионов кислорода (ковалентность связи Cu-O) на ионе меди в 3*d*-оболочке локализована не одна дырка, как в Cu^{+2} , а 0.75 дырки, как в $Cu^{1.75}$. Тогда магнитный момент ионов меди по теории должен быть равен $\mu_{Cu} = 0.75 \mu_{Cu,th} \approx 0.5 \mu_B$, что согласуется с экспериментом. На ковалентность связи Cu–O в плоскости CuO₂ также указывают экспериментальные данные по ядерному магнитному резонансу [22]. Таким образом, результаты данных экспериментов приводят нас к заключению, что заряд ионов меди в плоскости CuO₂ диэлектрической фазы ВТСП-системы La_{2-x}Sr_xCuO₄ равен Cu^{+1.75}.

Анализ электронной структуры ВТСП-систем с помощью квантового варианта метода Монте-Карло в приближении динамического кластера [23] (когда в кластере размером $(2a \cdot 2a)$, где a — расстояние между ближайшими ионами меди, точно учитывается корреляционное взаимодействие, а взаимодействие периодически расположенных таких кластеров учитывается в приближении среднего поля) показал, что в плоскости CuO₂ связь ионов меди и кислорода Cu–O в значительной доле является ковалентной. Это проявляется в обратном переносе части заряда, равной 0.27 заряда электрона, с ближайших ионов кислорода O^{-2} на ион меди Cu⁺². В результате в соединении La₂CuO₄ заряд на ионе меди (валентность) вместо Cu²⁺ становится Cu^{+1.73}.

Таким образом, как детальные нейтронографические эксперименты на качественных монокристаллах [20], так и расчеты методом [23], являющимся дальнейшим развитием современной динамической теории среднего поля [24], приводят к одному и тому же выводу о существовании заметной доли ковалентности в связи Cu–O в плоскости CuO₂ ВСТП-систем. Причем и в эксперименте, и в теории получены близкие величины заряда иона меди, равные +1.75 и +1.73 соответственно. Это происходит за счет перетекания 0.25 или 0.27 заряда электрона к иону меди от ближайших ионов кислорода в плоскости CuO₂ диэлектрической фазы ВТСП-систем.

Важным выводом, следующим из этих результатов, является то, что ионы кислорода в элементарной ячейке ВТСП-систем имеют разную валентность (заряд): O^{-2} и $O^{-\alpha}$, где $\alpha < 2$. Такая неоднородная электронная система в подрешетке кислорода диэлектрика должна упорядочиваться при достаточно низких температурах (если концентрация дефектов не превышает определенного минимума) из-за уменьшения при этом энергии системы.

2) Как отмечалось во Введении, в диэлектрической фазе ВТСП-систем наблюдается энергетическая щель $E_{\rm ct}$ из-за переноса заряда (Cu3*d*-O2*p*) [1], которая меньше величины хаббардовского межэлектронного (Cu3*d*-Cu3*d*) отталкивания *U*. Теоретические исследования показали (см., например, обзор [25]), что в двумерной квадратной решетке CuO₂ с учетом хаббардовского отталкивания *U* и магнитного взаимодействия спинов электронов $3d_{x^2-y^2}$ -состояний ионов Cu⁺² происходит образование синглетных валентных связей Cu-Cu, которые упорядочиваются при понижении температуры. Такое упорядочение синглетных валентных связей в



Рис. 1. Спин-пайерлсовское упорядочение, т.е. упорядочение валентных связей Cu–Cu (обозначены штриховыми линиями) в плоскости CuO₂ диэлектрической фазы ВТСП-систем [25,26]. *1, 2* — ионы меди (эти ионы имеют разное направление спинов), *3* — ионы кислорода O^{-2} , *4* — ионы кислорода $O^{-\alpha}$, где $\alpha < 2$. Ковалентные связи Cu– $O^{-\alpha}$ –Cu также обозначены штриховыми линиями, т.е. упорядочение валентных связей Cu–Cu приводит к упорядочению ковалентных связей Cu– $O^{-\alpha}$ –Cu.

диэлектрике называют спин-пайерлсовским или упорядочением зарядов на связях [25,26]. Пример упорядочения валентных связей Cu–Cu представлен на рисунке, где дополнительно показаны ионы кислорода в плоскости CuO₂. Валентные связи на рисунке обозначены штриховыми линиями, и их упорядочение приводит к удвоению периода решетки типа $(2a \cdot a)$.

3) Образование спин-пайерлсовских синглетных валентных связей Cu-Cu в плоскости CuO₂ приводит к тому, что из четырех ионов кислорода, окружающих каждый ион меди, только один ион кислорода находится на валентной связи Cu-Cu и поэтому является выделенным (на рисунке обозначен заштрихованным кружком). В результате этого происходит более сильная гибридизация 2р-состояний данного выделенного иона кислорода с $3d_{x^2-y^2}$ -состояниями двух ионов меди, образующих данную валентную связь, по сравнению с тремя другими ионами кислорода вокруг иона меди. Сильная гибридизация кислородных состояний на валентной связи приводит к переносу части электронного заряда с выделенного иона O^{-2} на ионы Cu^{+2} , образующие валентную связи, т.е. связь Cu-O-Cu на валентной связи Си-Си становится ковалентной, а величина отрицательного заряда этого выделенного иона кислорода на рисунке уменьшается до $O^{-\alpha}$, где α < 2. Каждый ион Си участвует в образовании только одной связи Cu-O^{-*a*}-Cu. На два иона Cu приходится один ион $O^{-\alpha}$. В результате этого образуются цепочки типа O^{-2} -Cu- $O^{-\alpha}$ -Cu- O^{-2} с удвоенным периодом решетки в плоскости CuO₂. Таким образом, образование спин-пайерлсовских связей Си-Си [22] приводит к образованию спин-пайерлсовских ковалентных связей

Си-О^{-а}-Си в плоскости СиО₂ с результирующим удвоением периодов решетки. В подрешетке кислорода в плоскости CuO2 диэлектрика возникает спинпайерлсовская волна зарядовой плотности (СП ВЗП) типа $O^{-2} - O^{-\alpha} - O^{-2}$. По аналогии с ковалентными полупроводниками (Si, Ge и т.д.), где эффект ковалентности проявляется в образовании ковалентных зарядов на связях, в диэлектрической фазе ВТСП вместо СП ВЗП необходимо применять термин "спинпайерлсовские" заряды на связях. Как отмечалось выше, из эксперимента и теории следует [20,23], что в диэлектрической фазе валентность ионов меди не Cu^{+2} , а $Cu^{+1.75}$. Такое уменьшение заряда иона меди до +1.75 происходит за счет переноса 0.25 электрона с ближайшего выделенного иона кислорода на валентной связи. Следовательно, выделенный ион кислорода на рисунке отдает 0.25 электрона иону меди слева от него и 0.25 электрона иону меди справа от него, в результате чего ион кислорода на валентной связи имеет заряд $O^{-1.5}$ (на рисунке $\alpha = -1.5$). Сверхструктурное зарядовое упорядочение в направлении [100] является дополнительным к антиферромагнитному упорядочению ионов меди в направлении [110]. Удвоение периодов решетки приводит к появлению нового вектора обратной решетки $\mathbf{G}_2 = \mathbf{G}/2 = (\pi/a)[100],$ где $\mathbf{G} = (2\pi/a)[100]$ вектор обратной решетки без удвоения периода, т.е. для прямой решетки с периодом $(a \cdot a)$ [27].

4) В соседних плоскостях CuO_2 ковалентные связи упорядочиваются в перпендикулярном направлении. Таким образом, период решетки ВТСП-системы удваивается по всем трем направлениям: a, b и c.

5) Из теоретических расчетов [23] и из экспериментов [28–30] известно, что у потолка валентной зоны в диапазоне примерно 0.4-0.5 eV находятся в основном состояния 2*p*-ионов кислорода плоскости CuO₂. Ионы O^{-1.5} слабее связаны с решеткой по сравнению с ионами O⁻², поэтому именно состояния 2*p*-ионов O^{-1.5} находятся у потолка валентной зоны в диапазоне 0.4-0.5 eV.

В такой ячейке с удвоенным периодом по трем направлениям имеется четыре иона $O^{-1.5}$. Следовательно, на ячейку приходится шесть кислородных электронов, которые заполняют три зоны Бриллюэна (рассматривается случай отсутствия легирования). Отметим, что границы третьей зоны Бриллюэна для прямой ячейки с удвоенными периодами параллельны направлениям [100] и [010] в обратной решетке кристалла [27].

Теоретические оценки показывают [1,23], что у ВТСПсистем потолок валентной зоны находится в окрестности точек $(\pi/a)(\pm 1/2, \pm 1/2)$ исходной зоны Бриллюэна для исходной прямой решетки без удвоения периодов (т.е. для ячейки размером $(a \cdot a)$). Этот теоретический вывод согласуется с экспериментальными результатами, полученными методом ARPES [1]. При дырочном легировании вначале заполняются состояния в окрестности точек $(\pi/a)(\pm 1/2, \pm 1/2)$.

6) При слабом легировании, как показывают результаты ARPES [1], в ВТСП-системах возникают и сосуществуют две фазы: фаза с большой запрещенной энергетической щелью и фаза с малой энергетической щелью в окрестности точек $(\pi/a)(1,0)$ и $(\pi/a)(0,1)$ исходной зоны Бриллюэна для плоскости CuO₂. Одна из этих фаз (с большой щелью) соответствует нелегированной фазе, а вторая (с малой щелью) — это новая фаза, возникающая при легировании. При этом относительная доля новой фазы увеличивается с ростом уровня легирования. Эту ситуацию описывает страйповая модель неоднородного распределения дырок в кристалле. При легировании вместо равномерного распределения дырочных носителей по образцу происходит фазовое расслоение на области без дырочных носителей и области с сильным легированием. Например, для случая La_{2-x}Sr_xCuO₄ с 0.055 < x < 0.125 для области кристалла с сильным легирование граница Ферми пересекает границы исходной зоны Бриллюэна вблизи точек $(\pi/a)(\pm 1/4,\pm 1)$ и $(\pi/a)(\pm 1,\pm 1/4)$. В результате для параллельных участков границы Ферми возникает новый вектор обратной решетки, равный $G_4 = G_2/2 = G/4$, который является вектором нестинга. Как известно, нестинг приводит к пайерлсовской неустойчивости с образованием диэлектрической щели Δ^* и дополнительным удвоением периода решетки, т.е. в области с сильным легированием происходит учетверение периода исходной решетки. Такие области с учетверенным периодом решетки принято называть "страйпами" [6]. Эти области — пересекающиеся полосы в двух направлениях [100] и [010] — расположены в виде шахматной доски. Расстояния между такими полосами ("страйпами") тем меньше, чем выше уровень легирования. Такая картина в La_{2-r}Sr_rCuO₄ соответствует концентрации стронция x > 0.05. При меньших концентрациях стронция становятся существенными некоторые детали [6], такие как соотношение фазовых областей для рассеяния носителей заряда от границ второй и третьей зон Бриллюэна в окрестности точек $(\pi/a)(\pm 1/2, \pm 1/2)$. В результате этого направления "страйпов" при малых концентрациях стронция (x < 0.05) изменяются на [110].

Если обозначить через L период зарядового упорядочения в плоскости CuO₂ (т. е. расстояние между центрами "страйпов"), то легко показать, что величина L связана с уровнем легирования соотношением L = a/2x, где x меняется от x = 0 до некоторого $x = x_0 = 0.125$. Поскольку зарядовое упорядочение происходит в плоскостях CuO₂, где спины ионов меди упорядочены антиферромагнитно, "страйпы" играют роль границ антиферромагнитных доменов с разной фазой антиферромагнитного упорядочения. Отсюда следует, что периоду зарядовой модуляции L будет соответствовать период антиферромагнитной сверхструктурой модуляции, равный 2L.

При $x = x_0 = 0.125$ величина *L* становится равной $L = L_0 = 4a$, т.е. четырем периодам исходной решетки. Таким образом, на всей плоскости CuO₂ при таком

уровне легирования должно наблюдаться сверхструктурное зарядовое упорядочение, т.е. упорядочение "страйпов" с периодом 4*a*. Такая картина соответствует эксперименту [6].

7) Для нелегированной ВТСП-системы (x = 0) наличие СП ВЗП в плоскости CuO₂ или спин-пайерлсовских зарядов на связях означает чередование областей с повышенной и пониженной плотностью зарядов в подрешетке кислорода. Это явление аналогично появлению зарядов на связях в тетраэдрических полупроводниках [31]. Эти соединения имеют довольно "рыхлую" структуру с координационным числом 4. Такие рыхлые структуры нестабильны в приближении равномерного распределения электронной плотности [31-33]. Нестабильность проявляется в том, что для этих соединений частота поперечных акустических колебаний ω_{TA} (наиболее низкочастотная мода) на границе зоны Бриллюэна $\omega_{\mathrm{TA}} = \omega_{\mathrm{TA}}^*$ стремится к нулю. Однако учет в вычислениях влияния ковалентных зарядов на связях обеспечивает стабильность таких решеток. Эти заряды играют роль как бы дополнительных атомов, увеличивающих координационное число. В результате величина ω_{TA}^* становится положительной, а решетка стабильной. В этом случае в величине ω_{TA}^* имеются два вклада: ионный ω_{TA}^i и электронный ω_{TA}^{e} (т.е. вклад от зарядов на связях). Схематично ω_{TA}^* можно записать как сумму этих двух вкладов, т.е.

$$\omega_{\rm TA}^* = \omega_{\rm TA}^i + \omega_{\rm TA}^e. \tag{1}$$

При низких температурах $kT \sim \hbar \omega_{\text{TA}}^*$ величина ω_{TA}^* на границе зоны Бриллюэна обусловлена в основном вкладом ω_{TA}^e .

Похожая картина наблюдается и в ВТСП-системах, где роль зарядов на связях играют СП ВЗП. Устойчивость структур типа K_2NiF_4 (структура, в которой кристаллизуется ВТСП-система La_2CuO_4) обусловлена именно взаимодействием ВЗП с ионной решеткой.

8) Ситуация, рассмотренная в предыдущем разделе, должна сопровождаться целым рядом аномальных свойств соединений, в которых она осуществляется. В частности, должны наблюдаться аномальное поведение скоростей ультразвука, тепловых характеристик, фононных свойств. Например, тепловое расширение в области температур $kT \sim \hbar \omega_{TA}^*$ должно быть аномальным (отрицательным) при нагревании от низких температур. Действительно, ВЗП в системе возникает из-за нестинга. Известно [32,33], что при наличии конгруэнтных участков поверхности Ферми с энергией $E(\mathbf{k})$ и нестинга для волновых векторов **Q**, когда $E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k} + \mathbf{Q})$, низкочастотная электронная восприимчивость $\chi(\mathbf{Q})$

$$\chi(\mathbf{Q}) = \frac{1}{\Omega} \cdot \sum_{k} \frac{f(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k} + \mathbf{Q})}{E(\mathbf{k} + \mathbf{Q}) - E(\mathbf{k})}$$
(2)

расходится. Здесь f — функция распределения, Ω — объем элементарной ячейки.

Расходимость электронной восприимчивости приводит к отрицательной диэлектрической проницаемости электронной подсистемы $\varepsilon(\mathbf{Q})$ [32,33] для соответствующих волновых векторов

$$\varepsilon(\mathbf{Q}) = 1 + \frac{(4\pi e^2/Q^2) \cdot \chi(\mathbf{Q})}{1 - (4\pi e^2/Q^2) \cdot L(\mathbf{Q}) \cdot \chi(\mathbf{Q})} + \Delta\varepsilon.$$
(3)

Здесь e — заряд электрона, $\Delta \varepsilon$ — неособый вклад в диэлектрическую проницаемость, $L(\mathbf{Q})$ — поправка на локальное поле в кристалле ($0 < L(\mathbf{Q}) < 1$).

Таким образом, при нагревании в области низких температур, когда начинают возбуждаться низкочастотные фононы с волновым вектором Q и высокой плотностью состояний вблизи границы зоны Бриллюэна, будет наблюдаться сжатие решетки.

В тетраэдрических полупроводниках заряды на связях, т. е. ВЗП, соответствуют нестингу между плоскостями типа {110} (вектор нестинга $\mathbf{G} = (2\pi/a)[220]$). Поэтому в них диэлектрическая проницаемость для волновых вектров \mathbf{Q} и низких частот, соответствующих ω_{TA}^* на границе зоны Бриллюэна, отрицательна. Это и приводит к сжатию их решеток и аномальному (отрицательному) тепловому расширению в соответствующей области температур [34]. Аналогичная картина должна наблюдаться и в ВТСП-системах, для диэлектрической фазы которых $\mathbf{Q} = \mathbf{G}_2 = \mathbf{G}/2 = (\pi/a)[100]$ [27].

При дальнейшем нагреве, т.е. при $kT \gg \hbar \omega_{\text{TA}}^*$, возбуждаются высокочастотные ветви фононного спектра $\omega(\mathbf{k})$, определяемые в основном вкладом частот $\omega^i(\mathbf{k})$, для которых $\varepsilon(\omega, \mathbf{Q}) > 0$. Это приводит к эффективному увеличению расстояний между ионами из-за их тепловых колебаний, и тепловое расширение становится нормальным ($\alpha > 0$), т.е. определяется обычным ангармонизмом [34]. Роль ВЗП в этой области температур в тепловом расширении становится пренебрежимо малой.

9) Сжатие решетки при нагревании из-за наличия зарядов на связях можно проиллюстрировать следующей упрощенной схемой. Рассмотрим ионную решетку, в которой между ионами расположены электронные заряды на связях, имитирующие возможные сложные ВЗП. Решетка при этом электронейтральна и дипольный момент в статике отсутствует. При частотах $\omega \sim \omega_{\mathrm{TA}}^*$ при смещении зарядов на связях из положений равновесия возникают дипольные моменты. Это приводит к смещению положительных ионов к зарядам на связях и, следовательно, друг к другу. Время релаксации для ионов больше, чем для электронов, поэтому возникающая поляризация решетки релаксирует медленнее. Соседние электронные заряды на связях начинают притягиваться к возникшей области с избыточным положительным зарядом. А это соответствует общему сжатию решетки, т. е. *α* < 0 (и отрицательности диэлектрической проницаемости $\varepsilon < 0$).

Ситуация напоминает куперовское притяжение двух электронов в сверхпроводниках из-за поляризации решетки (возникновения области избыточного положительного заряда), создаваемой этими электронами. Кстати, эта ситуация тоже отвечает случаю $\varepsilon < 0$ для соответствующей области частот и волновых векторов.

Итак, в нелегированных или слабо легированных ВТСП-системах с заметной долей ковалентности связей Cu-O в плоскости CuO_2 в дополнение к антиферромагнитному и спин-пайерлсовскому упорядочению в подрешетке ионов меди имеется СП ВЗП в подрешетке ионов кислорода, стабилизирующая решетку. Наличие такой СП ВЗП должно проявляться в аномальном (отрицательном) тепловом расширении при низких температурах.

10) Важным является вопрос о роли магнитного поля. Как известно [32], возникновение диэлектрической щели в случае ВЗП можно описывать в терминах электрондырочного спаривания. Магнитное поле рвет эти синглетные пары, т.е. уменьшает их плотность *n*. Уменьшение плотности синглетных пар соответствует уменьшению амплитуды ВЗП (CDW) А_{CDW}. В эксперименте это должно проявляться в аномально сильном влиянии магнитного поля на тепловое расширение в области низких температур $kT \sim \hbar \omega_{\mathrm{TA}}^*$. В нашем случае при низких температурах, согласно (1), величина $\omega_{TA}^* \sim \omega_{TA}^e$ пропорциональна амплитуде СП (SC) ВЗП, которая в свою очередь пропорциональна плотности электрондырочных пар, т. е. $\omega^*_{\rm TA} \sim A_{\rm SC\ CDW} \sim n.$ Поэтому с ростом магнитного поля величина ω_{TA}^* будет уменьшаться, что должно приводить к снижению температуры, при которой наблюдается аномалия теплового расширения.

11) Легирование, т.е. увеличение концентрации свободных носителей, также должно приводить к уменьшению амплитуды СП ВЗП $A_{\rm SC\ CDW}$ из-за увеличения кулоновского экранирования. Даже при наличии страйповой структуры легирование приводит к увеличению диэлектрической проницаемости ε и уменьшению вклада СП ВЗП. При сильном легировании страйповая структура постепенно размывается и электронная структура ВТСП-соединения приобретает свойства обычной Ферми-жидкости. Это приводит вначале к полному подавлению аномалии теплового расширения и в конце концов к потере устойчивости решетки кристалла.

3. Обсуждение

Физическая модель, изложенная в настоящей работе и связывающая наличие аномалий теплового расширения в ВТСП-системах с их неустойчивостью, является развитием модели сверхструктурной модуляции ВТСП-систем, предложенной нами ранее [27]. Полученные нами экспериментальные результаты по тепловому расширению монокристаллов системы $Bi_2Sr_{2-x}La_xCuO_6$ [8] согласуется с этой моделью. Модель объясняет также наблюдавшиеся ранее в ряде ВТСП-систем аномалии теплового расширения [9–19]. Трудно объяснить эти аномалии обычным ангармонизмом в области температур 5–10 К. Здесь определенно должно быть примени-

мо квазигармоническое приближение, справедливое для $T < \Theta/10$, где Θ — температура Дебая [2].

Влияние умеренных магнитных полей (H = 2-4 T) на тепловое расширение в области аномалии модель связывает с их влиянием на волну зарядовой плотности, стабилизирующую ВТСП-систему. Экспериментально наблюдалось аномально сильное влияние магнитных полей при низких температурах также и на другие упругие характеристики ВТСП-систем, такие как скорости звука [4]. Влияние магнитного поля на эти характеристики указывает на электронную природу наблюдаемых явлений, что также свидетельствует в пользу предлагаемой нами модели.

Наблюдение аномалий теплового расшинения при низких температурах и влияния на них умеренных магнитных полей в целом ряде ВТСП-систем указывает на то, что эти аномалии являются фундаментальным свойством всех этих систем. Это свойство связано с нестабильностью таких систем. Возникновение сверхструктурного электронного упорядочения (спинпайерлсовской волны зарядовой плотности) позволяет стабилизировать решетку. Такой фундаментальный вывод требует исследования аномалий теплового расширения при низких температурах и в других ВТСПсистемах, в которых это не было сделано. В последние годы аномальное тепловое расширение при низких температурах найдено и в других, исходно неустойчивых системах [17]. Во всех случаях для стабилизации решетки возникает сверхструктурное упорядочение, т.е. либо ВЗП, либо заряды на связях [25,26]. Возникновение ВЗП наиболее благоприятно именно в квазидвумерных системах, какими являются ВТСП. Возникновение сверхструктурного упорядочения понижает энергию системы. Именно сохранение этого выигрыша в энергии является той фундаментальной причиной, которая приводит к аномальному тепловому расширению при низких температурах в таких системах.

Для купратной системы $Bi_2Sr_{2-x}La_xCuO_6$ [8] зависимость аномалии теплового расширения от уровня легирования качественно оказалась такой же, как для висмутатной системы Ba_{1-x}K_xBiO₃ [7]. В обеих системах аномалия теплового расширения в передопированных образцах исчезает. Одинаковый характер в обеих рассматриваемых системах носит и влияние магнитного поля на аномалию теплового расширения. Механизмы влияния ионов металла Си и Ві на кислородную подрешетку могут быть разными [7], но в результате в кислородной подрешетке образуется ВЗП, стабилизирующая ее. Качественное сходство аномалий $\alpha(T, H)$ в разных ВТСПсистемах, например в системах $Bi_2Sr_{2-x}La_xCuO_6$ [8], $La_{2-x}Sr_xCuO_6$ [3] и $Ba_{1-x}K_xBiO_3$ [7], указывает на то, что аномалии определяются прежде всего особенностями именно кислородной (анионной) подрешетки, а не подрешетки ионов металла Си или Ві. Это указывает на общность роли анионных подрешеток ВТСПсистем.

4. Заключение

В настоящей работе на основе идеи о сверхструктурном зарядовом упорядочении в кислородной подрешетке оксидных ВТСП-систем предложена физическая модель, предсказывающая возникновение в них аномального теплового расширения при низких температурах и сильное влияние магнитного поля на эту аномалию. В этой модели из анализа новейших экспериментальных данных по спектроскопии ВТСП (нейтронография, ARPES), а также теоретических данных о распределении электронной плотности показано, что в ВТСП-системах должны наблюдаться аномалии $\alpha(T, H)$, которые обусловлены существованием ВЗП в кислородной подрешетке, возникающих вследствие спин-пайерлсовского и антиферромагнитного упорядочения в подрешетке ионов меди для купратных ВТСП. При легировании, т.е. с ростом концентрации свободных носителей, а также при увеличении магнитного поля аномалии $\alpha(T, H)$ должны смещаться в область более низких температур, что связано с уменьшением амплитуды ВЗП и потерей структурной устойчивости ВТСП-систем. Весьма вероятно, что эти структуры существуют только благодаря ВЗП. Таким образом, наличие аномалий $\alpha(T, H)$, возможно, является одним из фундаментальных свойств купратных ВТСП-систем.

Список литературы

- A. Damascelli, Z. Hussain, Z.-X. Shen. Rev. Mod. Phys. 75, 473 (2003).
- [2] S. Baroni, S. Gironcoli, A. Dal Corso, P. Giannozzi. Rev. Mod. Phys. 73, 515 (2001).
- [3] A.I. Golovashkin, N.V. Anshukova, L.I. Ivanova, I.B. Krinetskii, A.P. Rusakov. Physica C 341–348, 1945 (2000).
- [4] T. Hanaguri, T. Fukase, T. Suzuki, I. Tanaka, H. Kojima. Physica B **194–196**, 1579 (1994).
- [5] M. Nohara, T. Suzuki, Y. Maeno, T. Fujita, I. Tanaka, H. Kojima. Phys. Rev. B 52, 570 (1995).
- [6] S.A. Kivelson, I.P. Bindlos, E. Fradkin, V. Oganesyan, J.M. Tranquada, A. Kapitulnik, C. Howald. Rev. Mod. Phys. 75, 1201 (2003).
- [7] Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, И.Б. Крынецкий, А.П. Русаков. Письма в ЖЭТФ 71, 550 (2000).
- [8] Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, И.Б. Крынецкий, А.П. Русаков. ФТТ 48, 1358 (2006).
- [9] Н.В. Аншукова, Г.П. Воробьев, А.И. Головашкин, О.М. Иваненко, З.А. Казей, И.Б. Крынецкий, Р.З. Левитин, Б.В. Миль, К.В. Мицен, В.В. Снегирев. Письма в ЖЭТФ 46, 373 (1987).
- [10] M. Lang, A. Höhr, H. Spille, F. Steglich, H. Rietschel, G. Roth, Y. Hidaka, T. Murakami. Z. Phys. B: Cond. Matter 74, 3 (1989).
- [11] H. You, U. Welp, Y. Fang. Phys. Rev. B 43, 3660 (1991).
- [12] H. Ogasawara, M. Matsukawa, K. Noto, H. Kimura. Proc. Int. Cryogenic Material Conf. Hawaii (1994). P. 315.
- [13] Z.J. Yang, M. Yewondwossen, D.W. Lawther, S.P. Ritcey, D.J.W. Geldart, R.A. Dunlap. J. Supercond. 8, 223 (1995).

- [14] Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, И.Б. Крынецкий, А.П. Русаков, Д.А. Шилятев. ФТТ 46, 1356 (2004); Кракт. сообщ. по физике. ФИАН, М. (2003). В. 8. С. 32.
- [15] Н.В. Аншукова, Б.М. Булычев, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, И.Б. Крынецкий, А.П. Русаков. ЖЭТФ 124, 80 (2003).
- [16] R. Lortz, C. Meingast, D. Ernst, B. Renker, D.D. Lawrie, J.P. Frank. J. Low Temp. Phys. **131**, 1101 (2003).
- [17] A. Hosomichi, Y. Xue, S. Naher, F. Hata, H. Kaneko, H. Suzuki. J. Phys. Chem. Sol. 66, 1583 (2005).
- [18] J.J. Neumeier, T. Tomita, M. Debessai, J.S. Schilling, P.W. Barnes, D.G. Hinks, J.D. Jorgensen. Phys. Rev. B 72, 220 505 (R) (2005).
- [19] A.C. Mclaughlin, F. Sher, J.P. Attfield. Nature 436, 829 (2005).
- [20] M. Matsuda, M. Fujita, K. Yamada, R.J. Birgeneau, Y. Endoh, G. Shirane. Phys. Rev. B 65, 134 515 (2002).
- [21] G. Xiao, M.Z. Cieplak, C.L. Chien. Phys. Rev. B 42, 240 (1990).
- [22] M. Takigawa, P.C. Hammel, R.H. Heffner, Z. Fisk, K.C. Ott, J.D. Thompson. Physica C 162–164, 853 (1989).
- [23] A. Macridin, M. Jarrell, Th. Maier, G.A. Sawatzky. Phys. Rev. B 71, 134 527 (2005).
- [24] A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth, M.J. Rosenberg. Rev. Mod. Phys. 68, 13 (1996).
- [25] S. Sachdev. Rev. Mod. Phys. 75, 913 (2003).
- [26] M. Vojta. Phys. Rev. B 66, 104 505 (2002).
- [27] Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, А.П. Русаков. ЖЭТФ **123**, 1188 (2003).
- [28] R. Müller, M. Schneider, R. Mitdauk, C. Janowitz, R.-St. Unger, A. Krapf, H. Dwelk, W. Frentrup, R. Manzke. Physica B 312–313, 94 (2002).
- [29] G. Ghiringhelli, N.B. Brookes, L.H. Tjeng, T. Mizokawa, O. Tjernberg, P.G. Steeneken, A.A. Menovsky. Physica B 312–313, 34 (2002).
- [30] O. Tjernberg, L.H. Tjeng, P.G. Steeneken, G. Ghiringhelli, A.A. Nugroho, A.A. Menovsky, N.B. Brookes. Phys. Rev. B 67, 100 501 (R) (2003).
- [31] H. Wendel, R.M. Martin. Phys. Rev. B 19, 5251 (1979).
- [32] Л.Н. Булаевский, В.Л. Гинзбург, Г.Ф. Жарков, Д.А. Киржниц, Ю.В. Копаев, Е.Г. Максимов, Д.И. Хомский. Проблема высокотемпературной сверхпроводимости / Под ред. В.Л. Гинзбурга, Д.А. Киржница. Наука, М. (1977). 400 с.
- [33] В.Л. Гинзбург, Е.Г. Максимов. СФХТ 5, 1543 (1992).
- [34] G.D. Barrera, J.A.O. Bruno, T.H.K. Barron, N.L. Allan. J. Phys.: Cond. Matter 17, R 217 (2005).